2025年４月期
決算説明会資料

2025年６月18日

インスペック株式会社

JQA-QMA16212

MS CM009

（証券コード：6656）

第１部　2025年4月期決算概況

第２部　中期経営計画
（2026/4期～2028/4期）

第１部　2025年4月期決算概況

第２部　中期経営計画
（2026/4期～2028/4期）

会社概要 （2025年4月30日現在）

超ハイエンドの精密電子部品外観検査で、グローバルニッチトップ

商号	インスペック株式会社
本社	秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79-1
創業	1984年（昭和59年）１月
上場市場	東京証券取引所スタンダード市場
代表者	代表取締役社長　菅原　雅史
主要製品	１．半導体パッケージ基板向けAOI ２．精密FPC向けロールtoロール型AOI ３．半導体パッケージ基板向けAOS ※AOI：自動外観検査装置 ※AOS：レーザーリペア装置
従業員	85名
資本金	813百万円
発行済株式数	4,012,800株（単元株数：100株）
株主数	4,911名

角館の四季

Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

2025年４月期　業績ハイライト

・基板検査装置関連事業の売上は堅調に推移したものの、露光装置関連事業の受注・売上が獲得できず当初計画から未達
・営業利益は計画通りとなったものの、事業撤退損計上により最終利益は未達

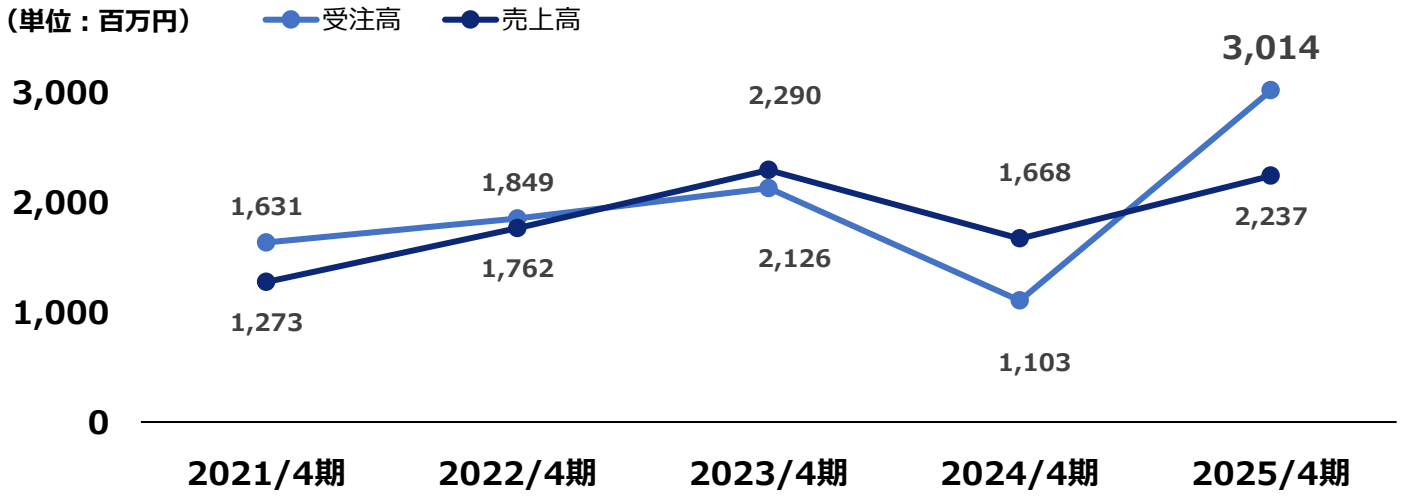
（単位：百万円）

	2025年４月期	2024年４月期	前年同期比	増減率	2025年4月期 業績修正
売上高	2,237	1,668	569	34.1%	2,200
営業利益	108	△233	342	―	100
経常利益	116	△263	380	―	100
当期純利益	△142	△353	211	―	△150

Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

受注高及び売上高推移

過去5年間の推移



過去最高

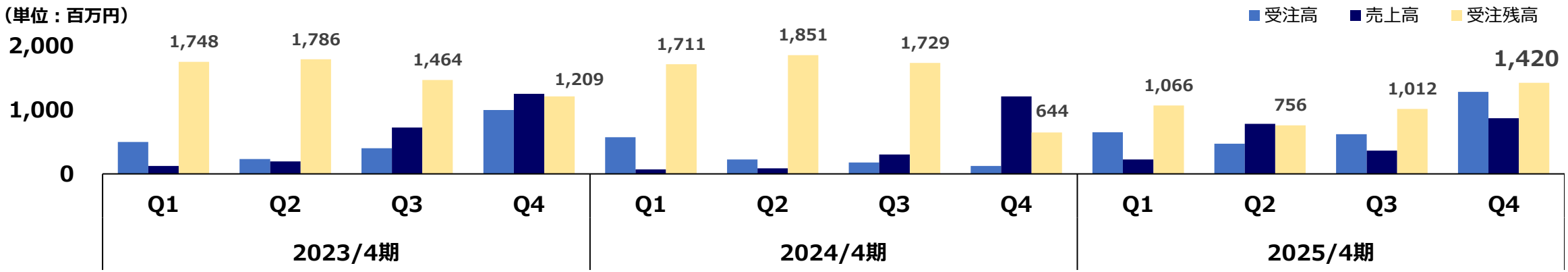
2025/4期受注高

3,014百万円　（前年同期比　173.3%増）

2025/4期末受注残高

1,420百万円　（前年同期比　120.6%増）

四半期毎の推移



Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

大型受注獲得

生成AI半導体関連市場が活況を呈する中、当社が強みを持つ検査装置の性能及びサポート体制がユーザー様から高く評価され複数の大型受注を獲得

半導体パッケージ基板検査装置（AVI）

半導体パッケージ基板検査装置（AOI）

ロールtoロール型検査装置

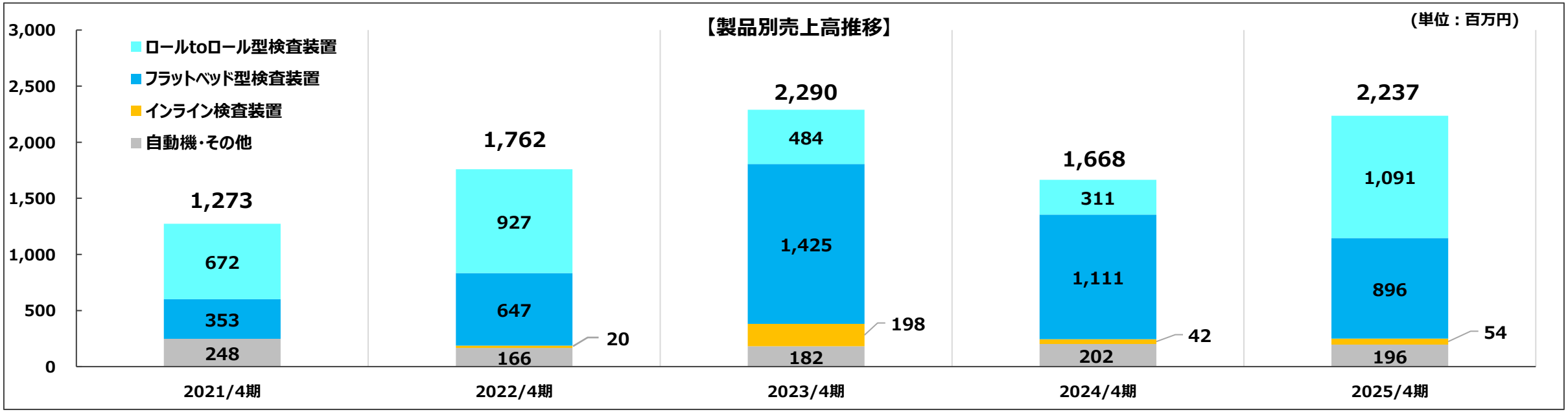
2025年1月	3.9億円
2025年4月	11.5億円
2025年5月	4.6億円

国内外の企業より、ロールtoロール型検査装置、半導体パッケージ基板検査装置及びその付帯装置、外観検査装置の受注を獲得

Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

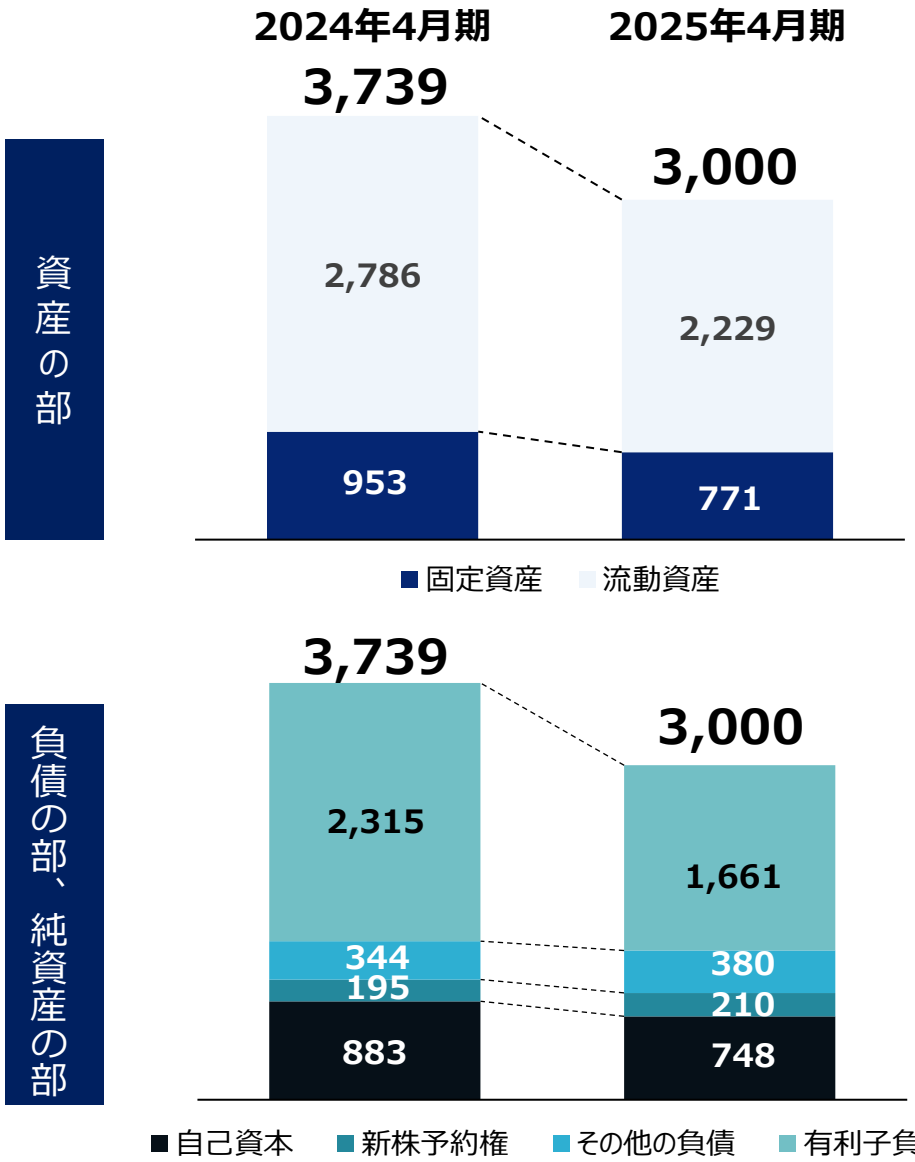
製品別売上高

	2025年４月期		2024年４月期		前年同期比増減率
	金額（百万円）	構成比	金額（百万円）	構成比	
売上高合計	2,237	100.0%	1,668	100.0%	34.1%
ロールtoロール型検査装置	1,091	48.8%	311	18.7%	250.0%
フラットベッド型検査装置	896	40.1%	1,111	66.7%	△19.4%
インライン検査装置	54	2.4%	42	2.5%	29.5%
自動機・その他	196	8.7%	202	12.1%	△3.4%



Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

要約貸借対照表



	2024年4月期	2025年4月期
自己資本	883百万円	748百万円
自己資本比率	23.6%	24.9%

【主な増減要因】

現金及び預金：198百万円減少
売掛金：51百万円減少
電子記録債権：187百万円増加
仕掛品：459百万円減少
機械及び装置：127百万円減少

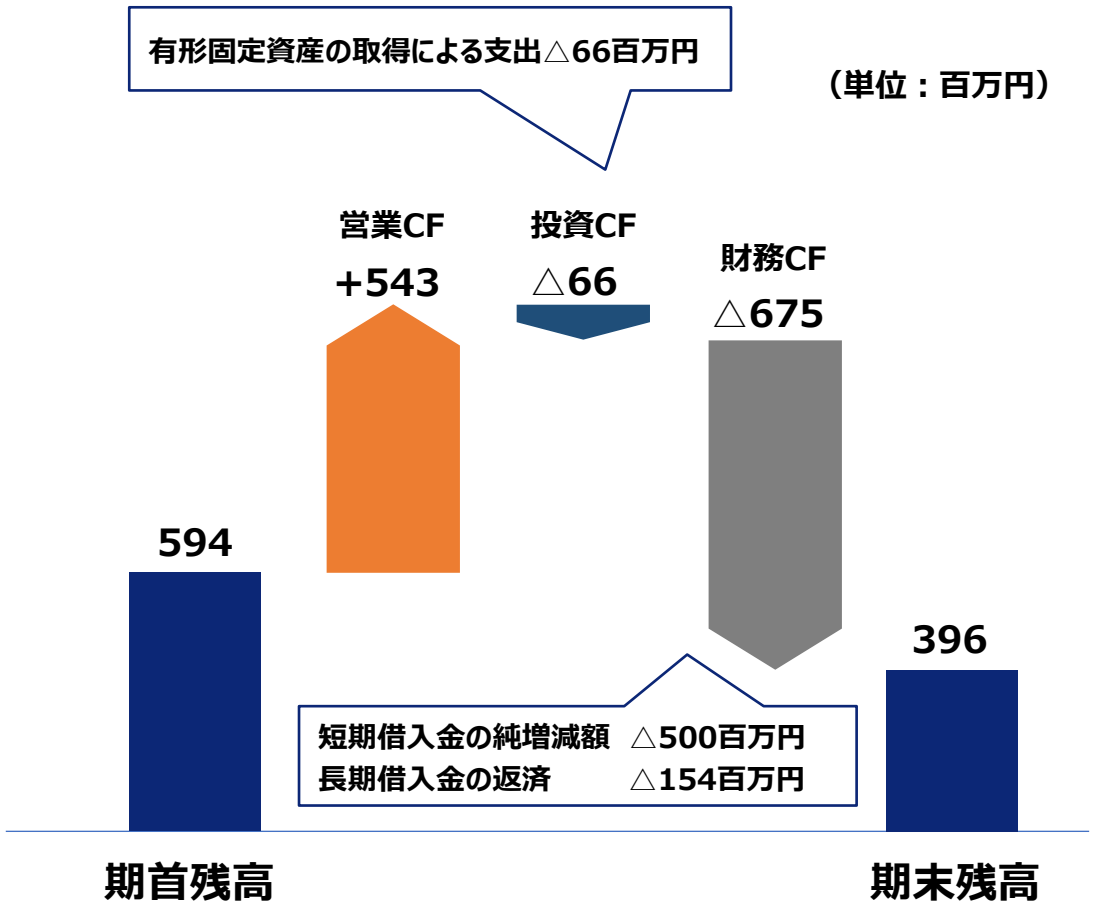
短期借入金：500百万円減少
長期借入金：154百万円減少

当期純損失の計上：142百万円

Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

要約キャッシュ・フロー計算書

現金及び現金同等物　198百万円の減少



（単位：百万円）

	2024年４月期	2025年４月期
期首現金及び現金同等物残高	437	594
営業活動によるキャッシュ･フロー	105	543
投資活動によるキャッシュ･フロー	△77	△66
フリーキャッシュ･フロー	27	477
財務活動によるキャッシュ･フロー	129	△675
現金及び現金同等に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（減少△）	157	△198
期末現金及び現金同等物残高	594	396

Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

研究開発費

	2025年４月期		2024年４月期		対前年増減率
	金額（百万円）	対売上比	金額（百万円）	対売上比	
基板検査装置関連事業	252	11.2%	205	12.2%	22.6%
露光装置関連事業	105	N/A	219	N/A	△51.8%
合　計	358	16.0%	425	25.4%	△15.8%

■ 基板検査装置関連事業（半導体パッケージ基板検査装置・FPC検査装置）
・次世代及び次々世代の半導体パッケージ基板向けのウルトラファインAOIの開発
・リペア装置（AOS：光学式自動シェイピング装置）の開発及び次世代リペア装置の開発（Go-Tech事業）

■ 露光装置関連事業（ロールtoロール型直描露光装置）
・エレクトロニクス市場向け高性能露光装置の開発

Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

2026年４月期　通期業績予想

・生成AI向けデータセンターの大規模投資に伴う、半導体パッケージ基板市場の拡大は継続
・当社が強みを持つ高性能検査装置需要の高まりは当面続くと予想

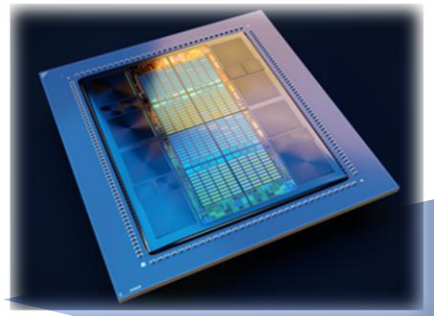
（単位：百万円）

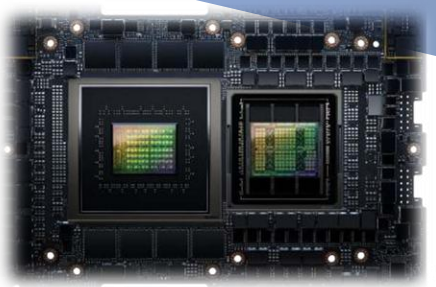
	公表値	前期実績	増減	増減率
売上高	2,300	2,237	63	2.8%
営業利益	120	108	12	10.4%
経常利益	70	116	△46	△40.1%
当期純利益	60	△142	202	–

Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

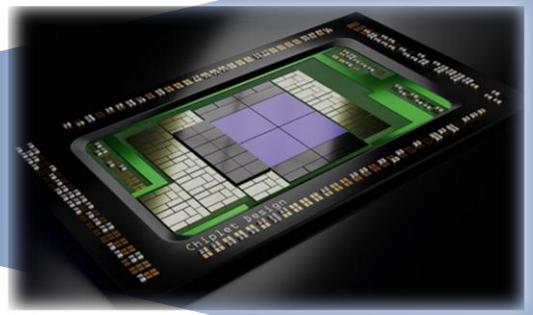
市場の拡大

生成AIの加速度的進化により、高性能半導体市場が拡大
高まる高性能検査装置需要に対応すべく技術開発を推進

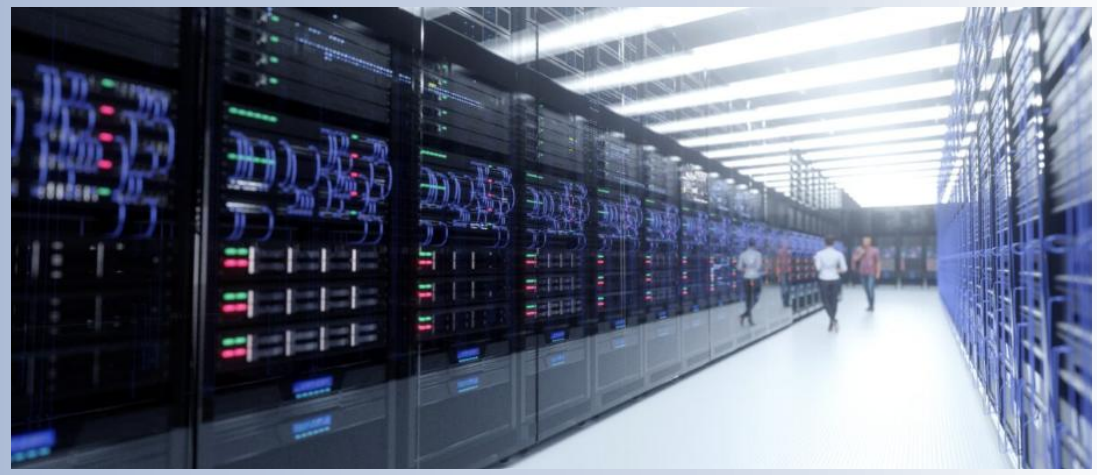




NVIDIA GH200 Grace Hopper
（出所：NVIDIA）



チップレット
（出所：東京エレクトロン）



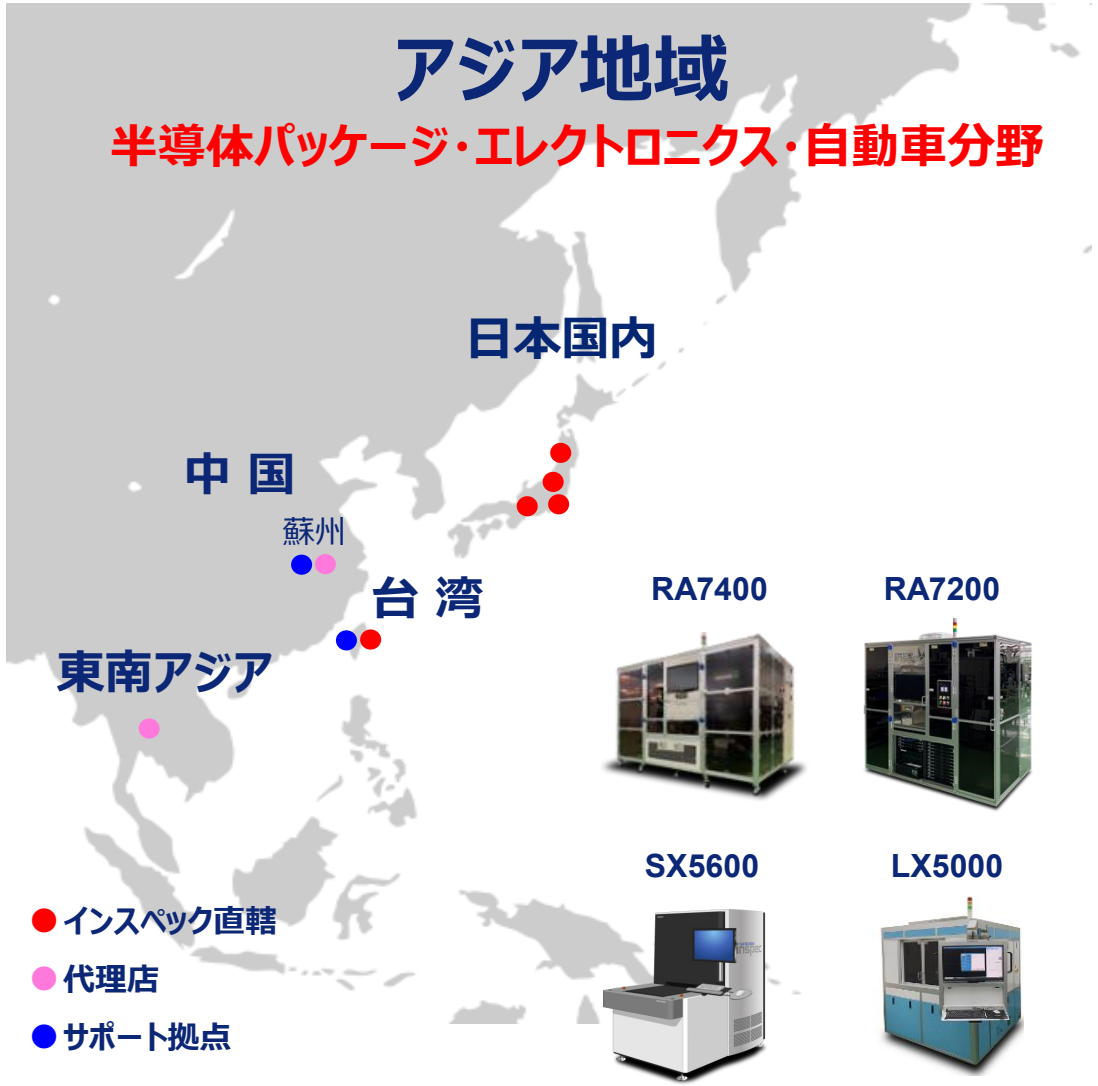
データセンター
（出所：ソフトバンク）

Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

国内外で積極的にPR活動を展開

アジア地域

半導体パッケージ・エレクトロニクス・自動車分野



JPCA Show 2025に出展

2025年６月４日～６日に東京ビッグサイトで開催された
「JPCA Show 2025 第54回国際電子回路産業展」に出展し、
商談に繋がるお問い合わせも多くいただくなど大盛況のうちに終了

【2025/4期出展実績】

2024年	5月	CPCA Show 2024（中国・上海）
	6月	JPCA Show 2024（日本）
	7月	THECA2024（タイ）
	12月	HKPCA Show　国際電子回路(深圳)展覧会（中国・深圳）
2025年	1月	オートモーティブワールド2025 第17回国際カーエレクトロニクス技術展（日本）
	3月	インテリジェント アジア タイランド 2025（タイ）
		CPCA Show 2025、SEMICON China 2025（中国上海）

Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

基本方針

当社は、パーパスのもと、基板検査装置関連事業の成長の持続と稼ぐ力の向上で企業価値拡大を図り、ROE15%以上を目指し、PBR向上を図ります。

■ROEとROICの推移

	2022/4期	2023/4期	2024/4期	2025/4期
ROE	18.6%	7.3%	△33.4%	△17.4%
ROIC	0.6%	2.5%	△5.0%	2.7%

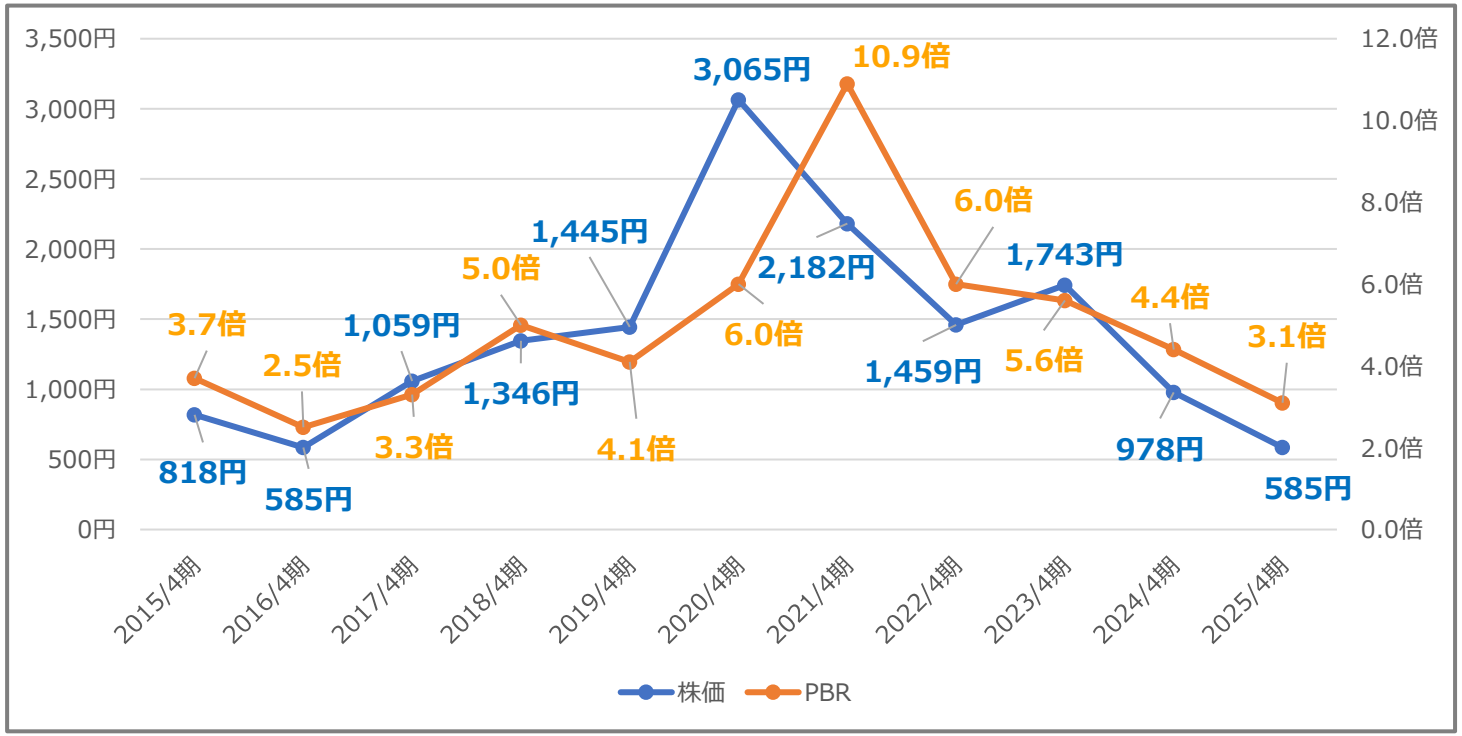
<当社予想>

	2026/4期	2027/4期	2028/4期
ROE	5.7%	5.1%	8.9%
ROIC	2.9%	3.2%	5.2%

■配当の推移

	2022/4期	2023/4期	2024/4期	2025/4期
1株当たり配当	3円	3円	–	–

■PBRと株価の推移



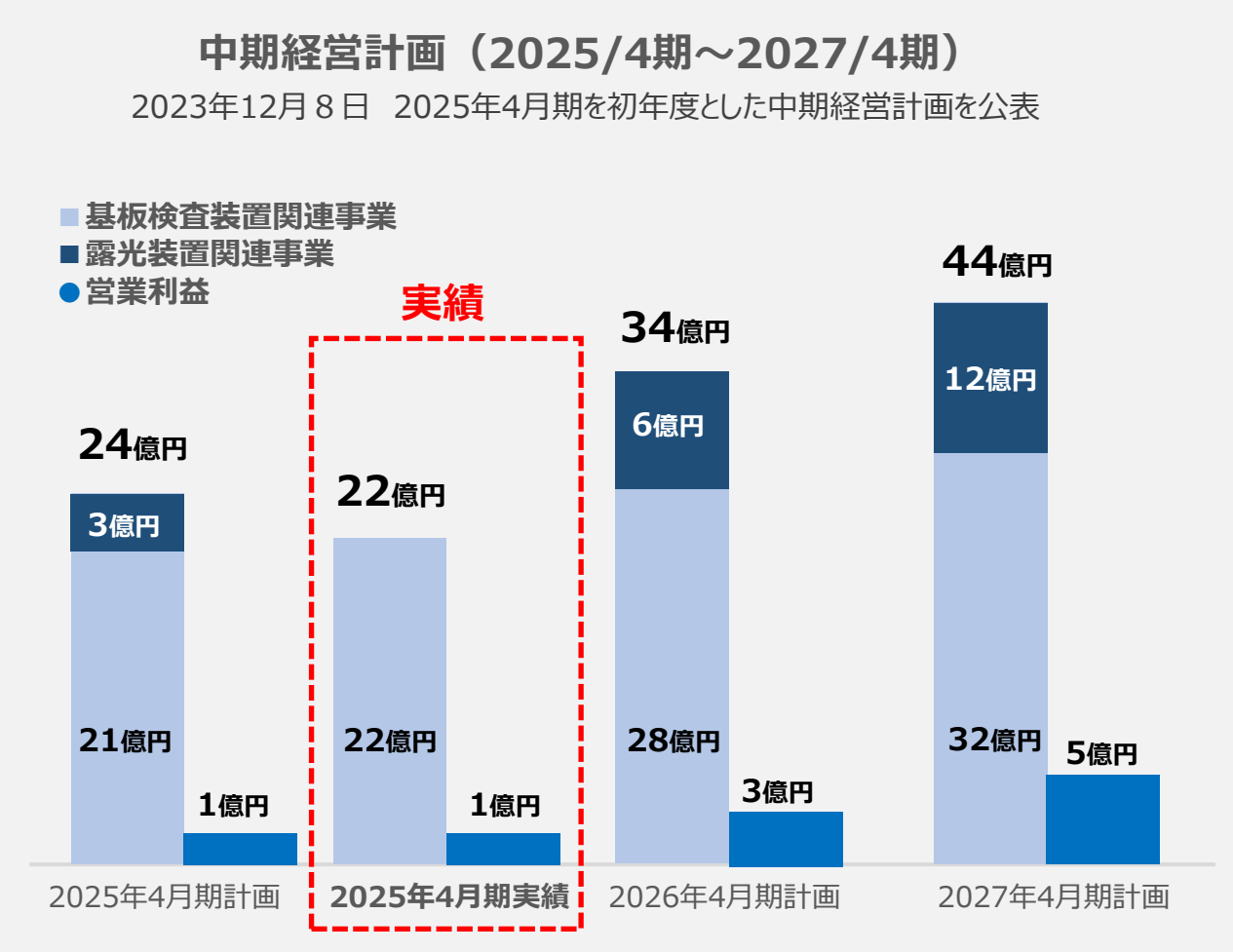
Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

第１部　2025年4月期決算概況

第２部　中期経営計画
（2026/4期～2028/4期）

振り返りと見直し

基板検査装置関連事業の売上、営業利益は、当初計画を達成
露光装置関連事業は当初の想定を大きく下回る需要減少が発生したため、撤退、中期経営計画を見直し



基板検査装置関連事業

生成AIの発展によりデータセンター向けの大規模投資、半導体パッケージ基板及びインターポーザー向け検査装置の新規需要の高まりにより当社の主力製品である高性能検査装置の引き合いが増加

露光装置関連事業

近年の電気自動車産業の停滞によりEV向けFPC市場の成長が鈍化し、当初の想定を大きく下回る需要減少が発生、市場環境の回復が短期的には見込まれず撤退

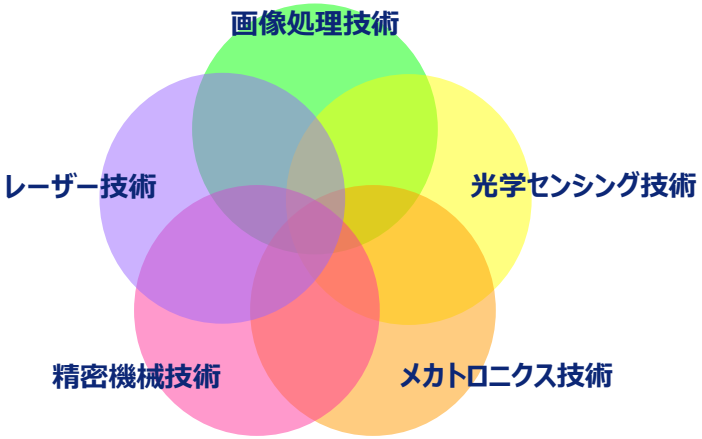
市場の拡大が続く、基板検査装置関連事業へ経営資源を集中
中長期的な企業価値の向上へ

Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

確かな技術とあくなき挑戦で、創造社会を切り拓く

社員が幸せになれる会社、そしてその先の誰もが輝き心豊かに生きることが出来る社会を目指して

確かな技術

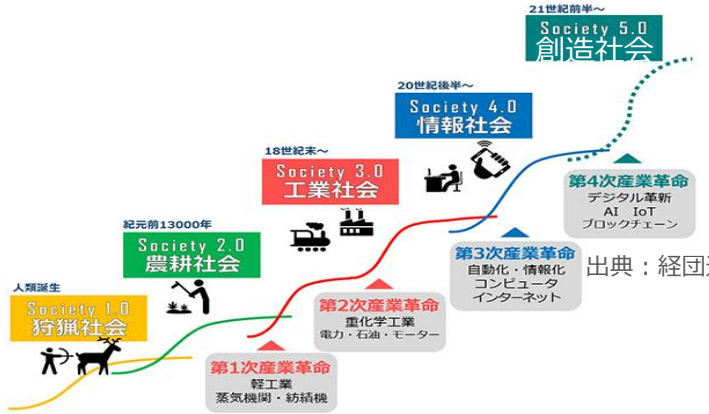


あくなき挑戦

当社の成長を牽引した製品たち

世に出ることはなかったが、現在の事業の礎となった製品たち

創造社会



出典：経団連

創造社会とは、**「誰もが輝き心豊かに生きることが出来る社会」**とあります。
創造社会の実現に貢献するためには、何よりも第一にインスペックの社員が幸せにならなければなりません。
「社員が幸せになれる会社」への取り組みこそが**創造社会の実現への取り組み**であり、まさにそのことが**インスペックの存在意義**です。

切り拓く

インスペックは自社が持つ技術・ノウハウを駆使して、まだ見ぬ明日へチャレンジし続けます。

Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

持続的成長へ向けて

Mission
変化を先取りし、革新的な製品を生み出す

今日の社会は人類が経験したことのない速さで変化が進んでいます。
私たちはこの変化を見据え、その先のニーズを先取りした優れた製品を提供します。

社会の繁栄と発展に貢献

基板検査装置関連事業

- 進化が加速する微細化・高機能化への対応
- 生産能力増強及びサプライチェーン強化
- 台湾、東南アジアへの販促強化

新規事業

- M&Aを視野に強力な成長エンジンとなる事業の展開を検討

Value

勇気と挑戦

失敗を恐れぬ挑戦と、
たゆまぬ努力が開く未来への扉

信頼と感謝

信頼と感謝が築く、
豊かで限りなき共生の輪

学びと成長

ものづくりは人づくり、
学びと成長はエンドレス

Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

経営方針

1. 高い競争力を持つ最先端の製品を開発し、業界をリードする
2. 収益性の高い、競争力のある事業構造を再構築する
3. アジアを中心としたグローバル市場の進出を拡大する
4. 人的資本に積極投資し、持続的成長を支える組織力を強化する
5. 働きがいが生み出す力で、社会の繁栄と発展に貢献する

Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

外部環境・事業環境認識

不安定な国際情勢による景気下振れリスクが高まるなど、先行き不透明感が継続
半導体市場においては、AI半導体関連を中心に技術の発展、進化のスピードが加速

2026年4月期

マクロ経済	・地政学的リスクの高まり ・先進国の少子高齢化による人手不足 ・新興国の経済成長率拡大 ・IoT・AIをはじめとするDX推進の加速 ・サスティナビリティに対する世界的な危機感の高まり
半導体・FPC市場	・シリコンサイクルからスーパーサイクルへ ・中国から東南アジアへ半導体市場のシフト ・生成AIが牽引する更なる微細化・高密度化 ・CASE対応への新たな価値創造
事業環境	・生成AI向けデータセンターの大規模投資継続による半導体パッケージ基板及びインターポーザー向け検査装置の新規需要の高まり ・半導体チップの微細化や、チップレット化へ向けた国内外企業の投資が活発化 ・生成AI搭載スマートフォン需要の増加

持続的成長と企業価値創造

確かな技術で競争力の高い製品を生み出し、社会の発展に貢献

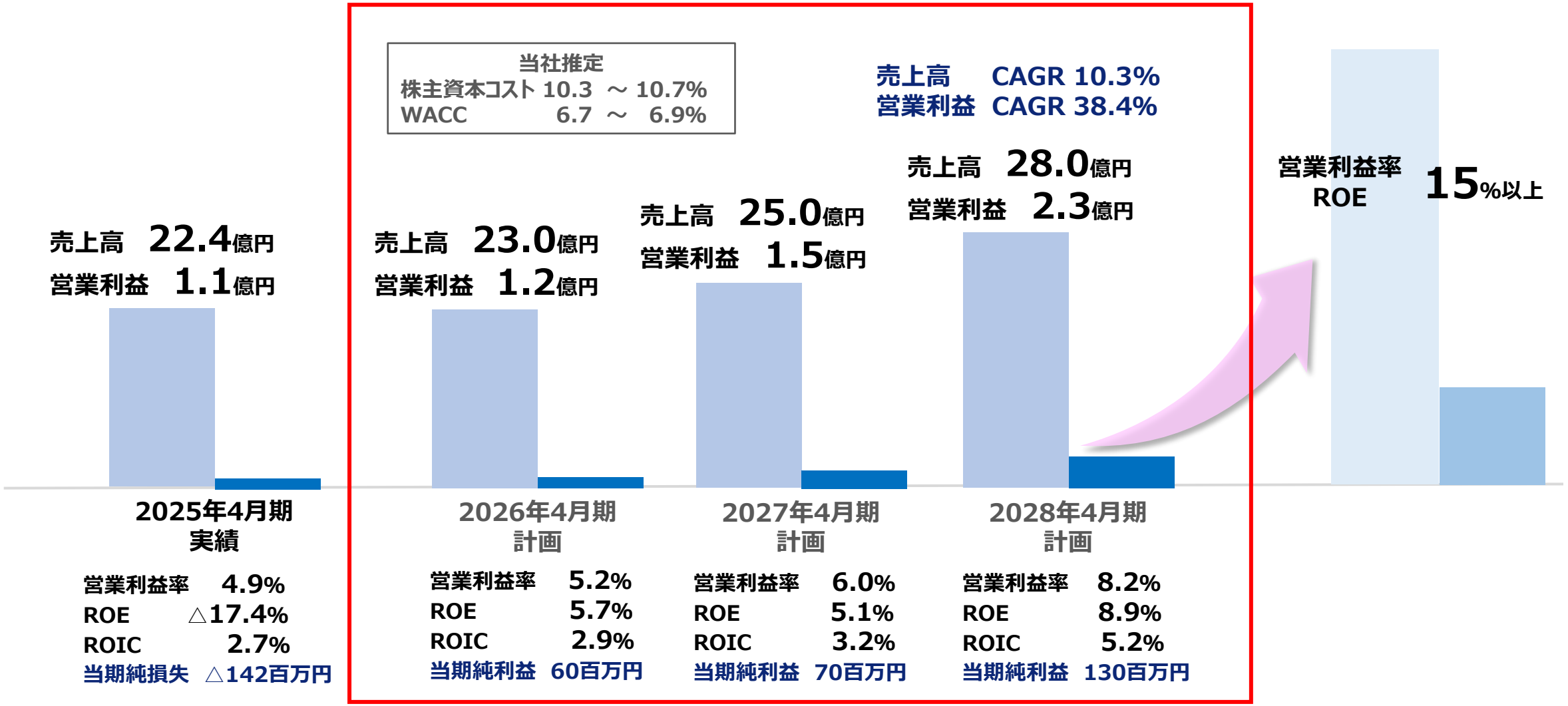
生成AIの加速度的進化に伴い、高性能半導体の市場拡大

半導体・FPC検査の微細化・高度化対応

Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

中期経営計画の概要

持続的成長で営業利益率15%、ROE15%以上を目指す



Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

事業戦略-基板検査装置関連事業

AIサーバーの拡大で、高性能CPU・GPUなどのハイエンドデバイスが急増
微細化、チップレット化で、より高機能化する半導体パッケージングへ対応する検査装置の開発と販売強化

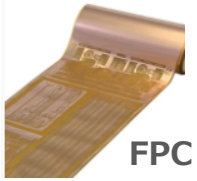
1. 半導体パッケージ基板の微細化・高度化への対応

- L/S=5μm/5μm→L/S=1μm/1μm
- ガラス基板等への応用
- 基板パッケージサイズ大型化へ対応

半導体パッケージ基板検査装置

2. FPCの需要拡大への対応

- AI搭載スマートデバイス向けFPC需要増
- ロール状での超高速検査を実現した主力製品の更なる進化

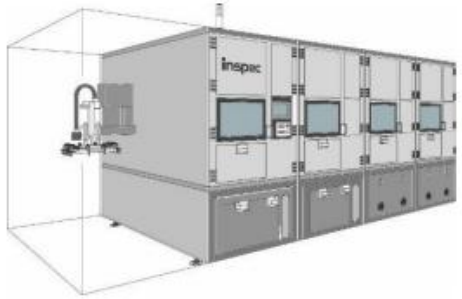


FPC

ロールtoロール型
FPC検査装置
『RA7400』

3. 全自動化システムの更なる進化

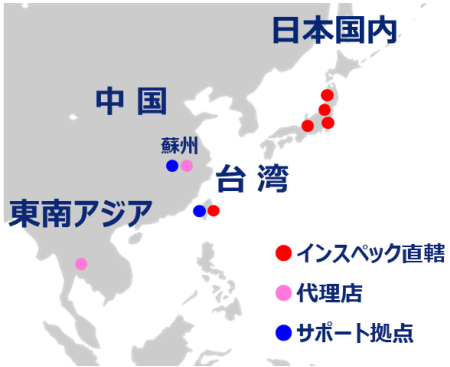
- AIサーバー拡大により高性能なCPU及びGPUが急増
- 拡大する高性能検査装置ニーズへ対応



AI機能付両面全自動検査装置
（イメージ図）

4. 更なる成長へ向け、事業基盤強化

- 生産能力増強
- サプライチェーン強化
- 海外拠点の強化
- 東南アジア地域への販促強化



Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

次世代最先端検査システムの開発が進行中

次世代CPU・GPUなどのハイエンドデバイスにおけるチップレット化で、より高機能化する半導体パッケージングへ対応する検査装置を開発

2025 → 2026 → 2027 → 2028

L/S=5μm/5μm

L/S=2μm/2μm

L/S=1μm/1μm

※L/S=ライン/スペース
配線の幅と隣り合う配線同士の間隔

SX7300

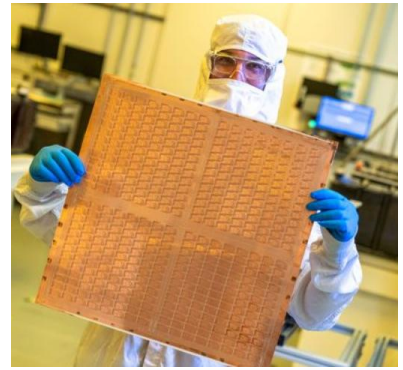
SX7400

SX7500

※SXシリーズ
半導体パッケージ基板向けAOI
（AOI：自動外観検査装置）

生成AIが作り出す未来に SX7000シリーズが貢献

次世代トレンド



ガラス基板（出所：インテル）

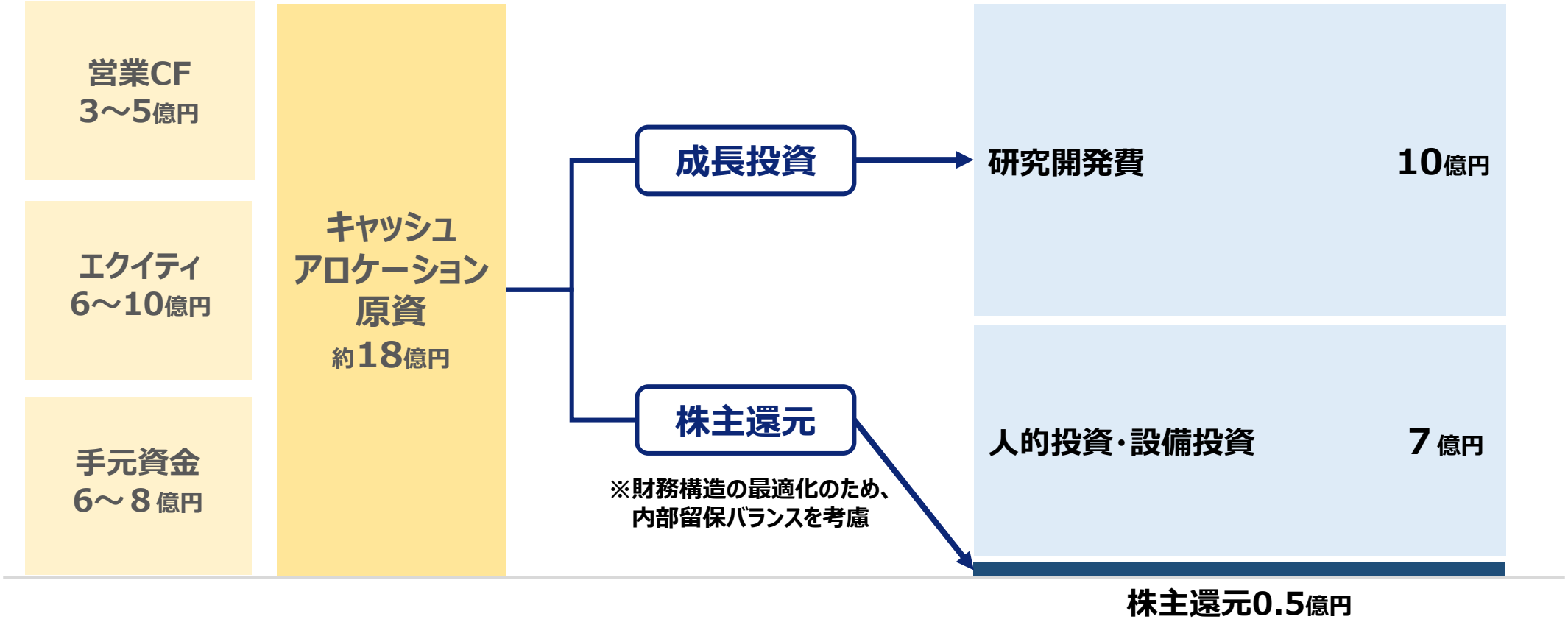
半導体パッケージ基板は 有機基板からガラス基板へ

Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

キャッシュ・アロケーション

中期経営計画３年累計の営業キャッシュ･フロー、発行済新株予約権（期限2026年４月）及び手元資金で成長投資に17億円、株主還元（配当）に0.5億円※を計画

■資金配分計画（2026年4月期～2028年4月期）



Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

人材戦略

人的資本に積極投資し、持続的成長を支える組織力を強化する

人事評価制度のブラッシュアップ

・社員の働きがいの向上を目指し、個が輝く人事制度を構築

2025年５月実績
・初任給引上げ 9.1%～12.9%
・ベースアップ 6.8%

教育研修制度の充実

・人材育成プログラムを策定

多様な働き方の支援

・時間単位の有給休暇と有給病気休暇の導入

ダイバーシティ採用へ

・地元採用による地域リレーション維持
・リモートワークを前提とした採用
・グローバル市場進出拡大に応じた
多様な人材の採用

従業員エンゲージメントの向上 → **企業価値向上** ↑ **IR・PR強化**

知名度・認知度向上

Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

CG強化

CG基本方針

当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンスを徹底するため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。
今後も企業価値を継続的に高めていくため、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくことを経営上の最も重要な課題のひとつと位置づけております。

●取締役会の機能強化

・公正かつ透明性の高い情報開示

・定期的な取締役会実効性評価の実施と評価結果の活用

・独立社外取締役の増員検討

・取締役・監査役のトレーニング
（方針の策定と教育・研修プログラムの検討）

●資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

・財務構造の最適化

・成長戦略及び配当政策の策定
（中期経営計画）

・株主や投資家とのコミュニケーションの強化

Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

SDGsの取り組み

当社は、パーパス「確かな技術とあくなき挑戦で、創造社会を切り拓く」を通じて、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指します。

活力ある職場づくり

交流・能力開発・仕事と生活の調和によって働きがいのある職場づくり

- ■支援学校実習受け入れ
- ■インターンシップ受け入れ

- ■女性社員の雇用・活躍の推進
- ■出産・育児・介護休暇の取得推進

- ■有給休暇取得推進
- ■外部研修の実施

女性マネジメント塾

角館武家屋敷清掃活動

技術開発

検査装置の開発を通じて技術革新に貢献

- ■欠陥自動分類技術による人手不足解消への貢献
- ■電気自動車等のクリーンエネルギー技術発展への貢献

社会貢献活動

地域社会をはじめとした社会貢献活動を推進

- ■開発途上国にワクチン提供支援（ペットボトルキャップ・古着回収）
- ■社内献血活動

- ■再生可能エネルギー100%(RE100)の電力を導入

- ■角館武家屋敷清掃活動
- ■地元災害ボランティアへの登録

- ■フードロス対策自販機の社内設置
- ■社内空調にガスエアコンを使用
- ■照明のLEDライト化

- ■あきたSDGsパートナー登録
- ■地元スポーツ団体への協賛

プロバスケットボールチームオフィシャルスポンサー

Copyright 2025 inspec All Rights Reserved

ご注意

半導体パッケージ基板向けAOI『SX5600』

- インスペック基板AOIのフラッグシップモデル
- 最先端の超高精細基板に対応
- クラス最速レベルの生産性を実現

ロールtoロール型FPC検査装置『RA7400』

- ノンストップで高スループットと長尺対応の実現
- ベリファイレスをサポートする自動欠陥分類機能搭載
- コンパクトな外形

本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としたものではありません。
本資料を作成するに当たっては、正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。
本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及又は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることがあることをご承知おきください。

Copyright 2025 inspec All Rights Reserved